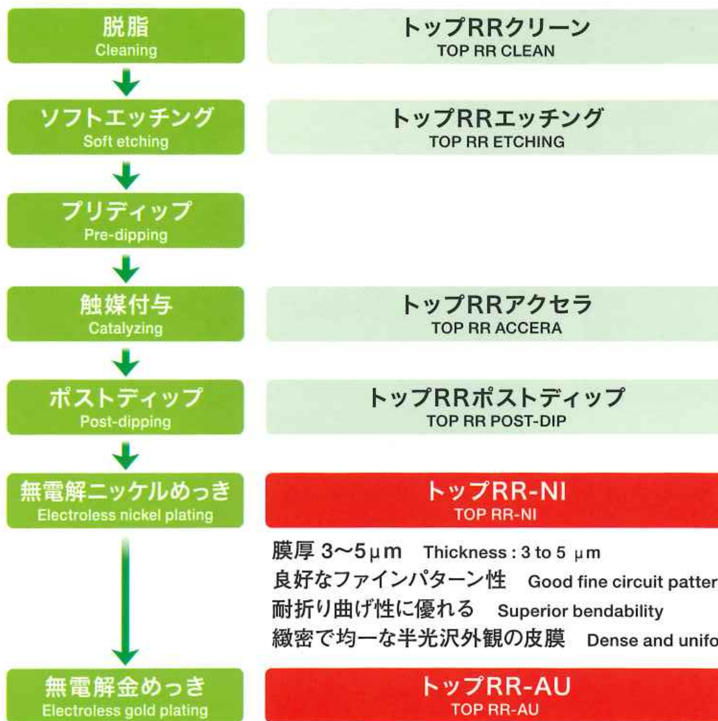
Roll to Roll 装置に適したフレキシブル基板対応の無電解ニッケル/金めっきプロセス
Applicable to Flexible PWB Electroless Nickel/Gold Plating Process to be Suitable for Roll to Roll Plating Equipment

トップRRプロセス
TOP RR PROCESS

- Roll to Roll 装置を用いることにより、電気銅めっきから連続しての生産が可能
- 無電解ニッケルめっき皮膜が持つ優れた耐折り曲げ性により、搬送による配線の断線がない
- 独立回路基板にも対応

- Continuous production from electro-copper plating film is available by using Roll to Roll plating equipment
- There is no disconnection of wiring by conveyance, since an electroless nickel plating film can provide a superior bendability
- Applicable to an isolated circuit boards



トップRR-NI

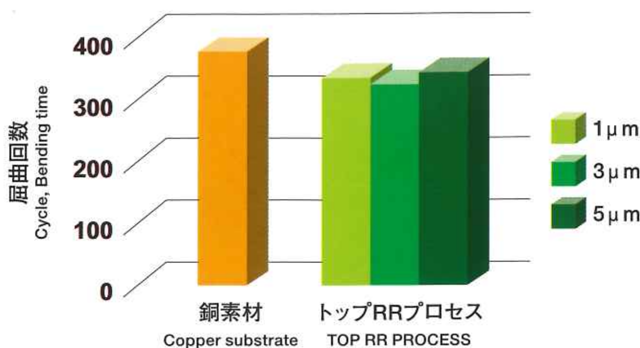
膜厚 3～5μm　Thickness : 3 to 5 μm
良好なファインパターン性　Good fine circuit pattern ability
耐折り曲げ性に優れる　Superior bendability
緻密で均一な半光沢外観の皮膜　Dense and uniform semi-bright plating film

トップRR-AU

膜厚 0.05μm　Thickness : 0.05 μm
下地の無電解ニッケルめっき皮膜への腐食がない　No corrosion to electroless nickel plating film as an underlayer
はんだ接合性が良好　Good solder jointing property
緻密で均一な外観の皮膜　Dense and uniform plating film

Roll to Roll 装置外観
Appearance of Roll to Roll plating equipment

耐折れ曲げ性（MIT試験）
Bendability（MIT test）



金めっき皮膜剥離後の表面観察画像
SEM image of a surface of electroless nickel plating film after stripped gold plating film